

表 2026年1月2日付承認プロジェクト一覧

	社名	製品
1	インディア・サーキット	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
2	バイタル・エレクトロニクス	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
3	シグナム・エレクトロニクス	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
4	エピトム・コンポーネンツ	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
5	BPL	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
6	AT&Sインディア	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
7	アセント・ケイ・サーキット	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
8	CIPSAテック・インディア	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
9	ショギニ・テクノアーツ	プリント基板（PCB）※高密度相互接続（HDI）含む
10	デキ・エレクトロニクス	コンデンサ
11	TDKインディア	コンデンサ
12	アンフェノール・ハイスピード・テクノロジー・インディア	高速伝送コネクタ
13	ユージャン・テクノロジー（インディア）	筐体（携帯電話・ITハードウェア・関連デバイス）
14	マザーサン・エレクトロニック・コンポーネンツ	筐体（携帯電話・ITハードウェア・関連デバイス）
15	タタ・エレクトロニクス	筐体（携帯電話・ITハードウェア・関連デバイス）
16	ATLバッテリー・テクノロジー（インディア）	リチウムイオン電池セル
17	ディクソン・エレクトロコネクト	光トランシーバー（SFP）
18	クンシャン・キュー・テック・マイクロエレクトロニクス（インディア）（印度丘鋇）	カメラモジュールサブアセンブリー
19	サムスン・ディスプレイ・ノイダ	ディスプレイモジュールサブアセンブリー
20	NPSPLアドバンスト・マテリアルズ	負極材
21	ウィプロ・グローバル・エンジニアリング・アンド・エレクトロニック・マテリアルズ	銅張積層板
22	ヒンダルコ・インダストリーズ	アルミ押出材

（出所）インド電子・情報技術省公表資料を基にジェトロ作成